

06.1;06.2

## ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРЯДА ДИЭЛЕКТРИКА И ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА КРЕМНИЙ — СВИНЦОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО

© П.Б.Парчинский, С.И.Власов, А.А.Насиров, Т.П.Адилов

Многокомпонентные свинцосодержащие стекла используются в микроэлектронике в качестве изолирующих и пассивирующих покрытий полупроводниковых приборов. Однако заряд, образующийся на границе раздела полупроводник-стекло в процессе формирования диэлектрических покрытий, оказывает влияние на характеристики пассивируемых приборов. Структурные и электрофизические свойства используемых покрытий зависят от состава стекол и режима их термической обработки [1].

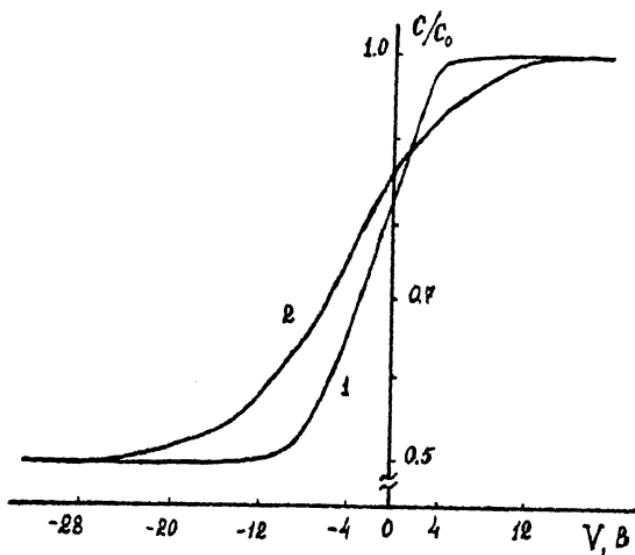
В настоящей работе приведены результаты исследования зарядов, локализованных вблизи скрытой границы раздела кремний-многокомпонентное стекло типа  $\text{PbO}-\text{SiO}_2-\text{B}_2\text{O}_3-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{Ta}_2\text{O}_5$ .

Исследуемые стекла наносились на подложку Si *n*-типа проводимости с кристаллографической ориентацией  $\langle 111 \rangle$  при помощи электрофореза ( $I = 10^{-4}$  А) с последующим оплавлением ( $T = 680^\circ\text{C}$ ) и отжигом при  $T = 470^\circ\text{C}$ . Концентрация мелкой примеси в полупроводниковой подложке составила  $9 \times 10^{13} \text{ см}^{-3}$ . Однородность и дисперсность состава контролировались при помощи электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа [2]. При помощи вакуумного распыления Al наносились управляющий (на стекло) и омический (на противоположную сторону кремниевой подложки) электроды, т. е. изготавливались структуры металл-диэлектрик-полупроводник (МПД).

В качестве основного метода исследования полученных структур использовался метод высокочастотных вольт-фарадовых характеристик [3] и его модификации [4].

На рисунке приведены типичные экспериментальная (кривая 1) и расчетная (кривая 2)  $C-V$  характеристики, нормированные к величине емкости диэлектрика, для одной из исследуемых МПД структур. Экспериментальная  $C-V$  зависимость была получена при помощи мостового компенсационного метода в темноте ( $f = 1.5 \cdot 10^5$  Гц,  $T = 20^\circ\text{C}$ ) с временной выдержкой в каждой точке.

На приведенных зависимостях хорошо выделяются два участка, соответствующие:  $V > 2$  В где экспериментальная  $C-V$  характеристика лежит правее теоретической, и



Типичные  $C-V$  зависимости МДП структур с диэлектриком на основе свинцовоборосиликатных стекол: 1 — теоретическая, 2 — экспериментальная.

$V < 2$  В, где эта характеристика проходит левее. Согласно общепринятой теории емкостного метода [3–5], на участке  $V > 2$  В суммарный заряд (заряд, локализованный в диэлектрике  $Q_0$ , и заряд поверхностных состояний границы раздела полупроводник–диэлектрик  $Q_{ss}$ ) является отрицательным, т. е.

$$Q_0 + Q_{ss} = Q^- \quad (1)$$

На участке при  $V < 2$  В суммарный заряд становится положительным, т. е.

$$Q_0 + Q_{ss} = Q^+ \quad (2)$$

Предположим, что поверхностные состояния представляют собой оборванные (ненасыщенные) валентные связи Si, которые приобретают положительный заряд при потере электрона, т. е. являются состояниями донорного типа [5,6]. Примем, как в случае границы раздела Si–SiO<sub>2</sub>, что величина заряда поверхностных состояний зависит от изгиба энергетических зон (т. е. от величины приложенного напряжения). С увеличением обедняющего напряжения, приложенного к МДП структуре, увеличивается число ионизированных поверхностных состояний, т. е. увеличивается положительный заряд границы раздела. Отрицательный заряд, наблюдаемый на экспериментальной зависимости, — это фиксированный, не зависящий от приложенного напряжения заряд, встроенный в структуру используемого стекла.

При напряжении  $V \sim 2$  В теоретические и экспериментальные зависимости совпадают. При этом напряжении заряд в диэлектрике и заряд, локализованный на поверхностных состояниях, совпадают по величине, но противоположны по знаку:

$$Q_0 + Q_{ss} = 0. \quad (3)$$

При больших обогащающих напряжениях ( $V > +16$  В) поверхностные состояния заполнены электронами практически по всей ширине запрещенной зоны кремния (за исключением узкого интервала энергий от  $E_c$  до  $E_c - 0.11$  эВ, где  $E_c$  — энергия дна зоны проводимости) и не создают значительного положительного заряда. В этом случае экспериментально определяемый по сдвигу  $C-V$  характеристик заряд обусловлен в основном отрицательным зарядом диэлектрика:

$$Q = C_0 \cdot \Delta V, \quad (4)$$

где  $C_0$  — экспериментально определяемая емкость диэлектрика,  $\Delta V$  — разность между экспериментальной и теоретической  $C-V$  зависимостями.

При больших напряжениях, соответствующих сильной инверсии поверхностной проводимости ( $V > -12$  В), практически все поверхностные состояния в интервале энергий от  $E_V + 0.17$  эВ до  $E_c$  (где  $E_V$  — энергия потолка валентной зоны в Si) ионизованы и создают положительный заряд. В этом случае результирующий заряд, определенный из  $C-V$  зависимости, в соответствии с (2) положителен и равен  $6 \cdot 10^{-10}$  Кл. При помощи выражений (1) и (4) в области сильного обогащения можно найти результирующий отрицательный заряд диэлектрика, равный  $3 \cdot 10^{-10}$  Кл. Предполагая, что заряд диэлектрика распределен по объему стекла равномерно, и используя (1) и (2), находим величину заряда поверхностных состояний  $Q_{ss} = 9.3 \cdot 10^{-10}$  Кл, что соответствует плотности поверхностных состояний  $N_{ss} = 6 \cdot 10^{11} \text{ см}^{-2}$ . Найденная величина  $N_{ss}$  сравнима с таковой для границы раздела Si-SiO<sub>2</sub>, полученной термическим окислением [7].

Отсюда следует, что основная причина, оказывающая влияние на изменение параметров пассивируемых свинцово-боросиликатным стеклом приборов, это не заряд, локализованный на поверхностных состояниях, а заряд, встроенный в структуру диэлектрика.

## Список литературы

- [1] Коньков В.М., Румак Н.В., Томченко А.А., Хатъко В.В. // Тез. докл. III Всес. конф. "Физика окисных пленок". Петрозаводск, 1991. Ч. 2. С. 14.
- [2] Насиров А.А., Парчинский П.Б., Адилов Т.П. // Тез. докл. конф. молодых физиков и математиков "Ташкентскому государственному университету — 75 лет". Ташкент, 1995. С. 14.
- [3] Terman L.M. // Solid. St. Electron. 1962. V. 5. P. 285–299.
- [4] Lindner R. // Bell. Syst. Tech. J. 1962. V. 41. P. 803–831.
- [5] Зи С. Физика полупроводниковых приборов. М.: Энергия, 1984. Т. 1. 456 с.
- [6] Shulz M. // Surf. Sci. 1983. V. 132. P. 422–455.
- [7] Барабан А.П., Булаевников А.П., Коноров П.П. Электронника слоев SiO<sub>2</sub> на кремнии. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1988, 303 с.

Поступило в Редакцию  
29 сентября 1995 г.

---